

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年2月9日(09.02.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/018048 A1

- (51) 国際特許分類:
B29C 59/02 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
B29C 33/40 (2006.01) B29K 33/04 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/067775
- (22) 国際出願日: 2011年8月3日(03.08.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-177602 2010年8月6日(06.08.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 綜研化学株式会社(SOKEN CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1718531 東京都豊島区高田三丁目2番5号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 山田 紘子(YAMADA, Hiroko) [JP/JP]; 〒3501320 埼玉県狭山市広瀬東一丁目1番1号 綜研化学株式会社内 Saitama (JP). 三澤 毅秀(MIZAWA, Takehide) [JP/JP]; 〒3501320 埼玉県狭山市広瀬東一丁目1番1号 綜研化学株式会社内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 S S I N P A T (SSINPAT PATENT FIRM); 〒1410031 東京都品川区西五反

田七丁目13番6号 五反田山崎ビル6階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

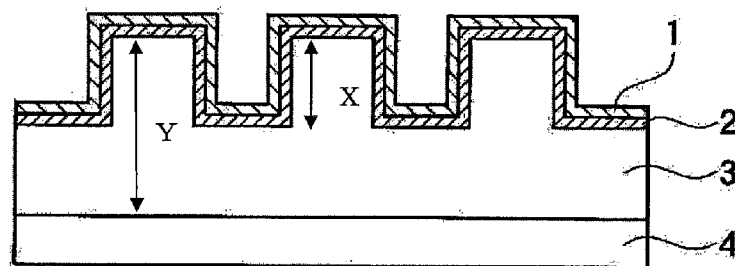
添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: RESIN MOLD FOR NANOIMPRINTING AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: ナノインプリント用樹脂製モールドおよびその製造方法

[図1]



(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a resin mold for nanoimprinting that has excellent, transfer defect-free releasability with the resin to be imprinted, and does not produce defects due to imprinting. The present invention also addresses the problem of providing a resin mold for nanoimprinting that does not produce peeling of the substrate and each layer when imprinting. This resin mold for nanoimprinting comprises: a substrate; a resin layer formed on the substrate and having an irregular pattern on the surface; an inorganic layer formed with a uniform thickness on the resin layer, at least on the surface having the irregular pattern on the surface; and a mold releasing agent layer formed with a uniform thickness on the inorganic layer, at least on the surface having the irregular pattern on the surface. The resin of the resin layer contains 1 to 50% of a constitutional unit derived from an epoxy group-containing unsaturated compound with respect to all constitutional units, and the epoxy value is 7.0×10^{-4} to 4.0×10^{-2} .

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2012/018048 A1